

DRAHTBONDSEMINAR TEIL 3 – SPECIALIST-LEVEL

PROZESSOPTIMIERUNG, DOE, URSACHENFINDUNG

Teil 3 wendet sich an erfahrene Anwender, die bereits erste Berührungen mit Prozessoptimierung gemacht und an Maschinen gearbeitet haben – oder Teil 1 und 2 bei Bond-IQ besucht haben.

Themenschwerpunkte sind Methoden zur Optimierung von Prozessparametern durch systematische Ansätze, d.h. Einfaktorielle Methoden und DoE. In Versuchen innerhalb von kleineren Versuchsgruppen wird die Methodik direkt am Beispiel angewendet. Dabei sind die Experimente vorausgewählt, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse in sich konsistent im Seminar umgesetzt und verstanden werden können.

Darüber hinaus wird das Thema FMEA, insbesondere die Veränderung von Prozesswissen im Unternehmen durch FMEA Methoden, thematisiert. Individuelle Bondversuche und ganz individuelle Prozessparametervariationen können in In-House Seminaren umgesetzt werden, die auf den Methoden und Inhalten des Teil 3 aufbauen.

Für das Seminar wird ein eigener Laptop empfohlen, um selbstständig mit den zur Verfügung gestellten Daten arbeiten zu können. Die Installation von Minitab sollte darauf möglich sein. Wenn dies nicht möglich ist – einfach eine kurze Information an uns und wir finden eine Lösung.

„Es wurde ein empfehlenswerter und praxisorientierter Einstieg in die statistische Versuchsplanung anhand Minitab geboten. Ich konnte damit meine Methodenkompetenz verbessern und hilfreiche Tipps für tägliche Excel Routine Probleme erhalten.“
(Sören Krille, First Sensor Microelectronic Packaging GmbH)



Ihr Lernerfolg

Wenn Sie das Seminar erfolgreich abgeschlossen haben, wissen Sie:

- was hinter der Methodik DoE steckt und wie sich diese von der einfaktoriellen Methode abgrenzt
- wann DoE für Bondverbindungen erfolgversprechend ist
- an konkreten Fallbeispielen, ausgewählt aus Bondprozessen, haben Sie erfahren, wie das Thema DOE ablaufen kann
- wie man Analysen unter Zuhilfenahme der Software Minitab durchführt
- wie Sie Prozesswissen in kompakter Form und abrufbar für FMEA oder Fehlersuche dokumentieren können

Zielgruppe

- Prozessentwicklung
- Produktionsverantwortliche
- Qualitätsverantwortliche
- Entwickler
- SQM-Verantwortliche
- Vorentwicklung

Ihre Vorteile

- schneller Wissenstransfer statt jahrelangem „learning by doing“
- nur relevantes anwenden – weniger Streuverluste bei Zeit und Kosten
- Praxiswissen aus anderen Blickwinkeln


2 Tage

max. 4 Teilnehmer € 1.970 €*
pro Teilnehmer

*Preisangaben pro Teilnehmer und zzgl. gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer

Informationen / Anmeldung unter:

 www.bond-iq.de

 +49 30 46069009

 seminaranfrage@bond-iq.de

DRAHTBONDSEMINAR TEIL 3 – SPECIALIST-LEVEL

PROZESOPTIMIERUNG, DOE, URSACHENFINDUNG

	Tag 1	Tag 2
09:00	Begrüßung und Vorstellung	Ermittlung DOE-Startparameter, Eingangsgrößen, Erstellung DOE-Plan
09:30	Berücksichtigung von Einflussfaktoren bei der Prozessoptimierung Prozess-FMEA Drahtbonden	Abarbeitung DOE-Plan, Ermittlung Ausgangsgrößen
10:00		
10:30		
11:00		
11:30	Mittagessen	Mittagessen
12:00		
12:30	Praxisübung zur einfaktoriellen Parameteroptimierung	Confirmation Trial, Finale Dokumentation
13:00		
13:30		
14:00	Auswertung der Ergebnisse, statistische Prüfung der Messreihen	Ursachenanalyse in fehlerhaftem Bondprozess
14:30		
15:00		Erfahrungsaustausch zu ergänzenden Themen
15:30		
16:00		

Ihr Referent

- Stefan Schmitz
// Bond-IQ GmbH
// Drahtbond-Technologie & Trainer
// Geschäftsführer Bond-IQ

Equipment

- F&S Bondtec 5610, 5630, 5650, 5632
- F&S Bondtec 5810, 5830, 5850
- Pulltester 100 g bis 5 kg
- Schertester 500 g bis 50 kg
- Lichtmikroskop 100x bis 1000x
- Stereomikroskop bis 60x

Hotelempfehlungen für Sie

- Hotel Grenzfall
Ackerstraße 136
13355 Berlin
Tel.: +49 30 34333300
www.hotel-grenzfall.de
- Mercure Hotel Berlin City
Invalidenstraße 38
10115 Berlin
Tel.: +49 30 308260
- Hotel Motel One Berlin Alexanderplatz
Dircksenstraße 36
10179 Berlin
Tel.: +49 30 20054080

„Auf unsere Fragen gab es immer eine klare Antwort. Bei außergewöhnlichen Spezialthemen konnte uns durch das große Netzwerk von BOND-IQ weitergeholfen werden.“
(Philipp Conrad, Würth Elektronik GmbH & Co. KG)



Informationen / Anmeldung unter:

- www.bond-iq.de
- +49 30 46069009
- seminaranfrage@bond-iq.de